**国家重点专项：MEMS传感器芯片先进封装测试平台项目启动**

来源：仪商网

3月25日上午，国家重点研发计划“智能传感器”重点专项“MEMS传感器芯片先进封装测试平台项目”启动会在苏州工业园区举行。该项目由苏州晶方半导体科技股份有限公司牵头承担，联合武汉大学、中科院微电子所、苏州大学等高校和科研院所共同攻关重点核心技术及产业化应用。

智能传感器是物联网、自动驾驶、先进制造等新兴数字经济的基石，国家重点研发计划“智能传感器”重点专项“MEMS传感器芯片先进封装测试平台项目”旨在突破我国高端MEMS芯片在封测上面临的技术难、成本高等“卡脖子”问题。

项目将在三年内，针对高端MEMS传感器先进封装测试需求，以核心工艺建模仿真与验证为基础，突破一系列晶圆级键合、垂直互连、激光划片等共性关键技术；形成硅和玻璃通孔晶圆级、集成无源器件晶圆级、扇出型晶圆级、MEMS与ASIC晶圆级集成和高可靠性系统级封装等成套先进封装工艺；建立基于标准的面向图像传感器、硅麦克风、加速度计、陀螺仪、压力传感器、红外传感器、流量传感器等高端传感器的先进封装测试公共服务平台，面向行业开展服务